

ZALECENIE KLEJENIA PANELI LAMINOWANYCH

De Lux Jodelka wodoodporna AC6 12 mm

Aquatus Jodelka klasyczna AC5 8mm

Klejenie do podkładu cementowego i anhydrytowego z masą samopoziomującą cementową i anhydrytową

- Podkład mineralny sprawdzić pod względem wytrzymałości (test twardości rysikiem stalowym), równości oraz określić jego temperaturę i wilgotność resztkową, np. przyrządem pomiarowym CM lub sondą elektryczną. Dopuszczalna wilgotność resztkowa do bezpośredniego klejenia paneli do podkładu cementowego wynosi 2,0% CM (z ogrzewaniem podłogowym 1,8%CM), do podkładu anhydrytowego wynosi 0,5% CM (z ogrzewaniem podłogowym 0,3%CM);
- podkłady należy szlifować papierem/siatką P12/P16, odpowiednim segmentem szlifującym lub frezować w celu usunięcia warstwy o niskiej wytrzymałości, zanieczyszczeń budowlanych; dokładnie odkurzyć;
- nierówności powyżej 2 mm na 2 mb, 2 mm na 1 mb lub powyżej 0,2 mm na 20 cm, uskoki powyżej 0,2 mm wypełnić masą szybkowiążącą SERVOFINE F333 Kiesel Bauchemie;
- w celu związania pyłu i zwiększenia przyczepności masy samopoziomującej, podkład zagruntować gruntem TEC PRIMER D /OKATMOS EG20 /OKATMOS UG 30 (1:1 z wodą) - czas schnięcia 60 minut dla p. cementowego, 24 godziny dla p. anhydrytowego (grunty: koncentrat);
- w przypadku podwyższonej wilgotności resztkowej jastrychu zastosować dwie warstwy „na krzyż” (druga warstwa po całkowitym wyschnięciu pierwszej) gruntu poliuretanowego jednoskładnikowego TEC PRIMER PU/PU FAST (do 4,0% CM), gruntu epoksydowego TEC PRIMER EPX/ OKAPOX GF (do 6,0% CM) – w przypadku wylewania masy samopoziomującej mokry grunt zasypać piaskiem kwarcowym uziarnienie 0,4-1,2 mm w ilości ok. 3,0 kg/m²; nie stosujemy bariery przeciwwilgociowej na podkładach mineralnych grzewczych;
- wylać warstwę masy samopoziomującej minimum 3 mm grubości, np. SERVOFIX USP, SERVOPLAN D800, SERVOPLAN S111, SERVOPLAN Ki1 Kiesel Bauchemie;
- Na czystą powierzchnię wylewki wykladać jednoskładnikowy TEC SPU - paca TKB B9 – zużycie max. 1,2 kg/m²;
- Od razu po wyłożeniu kleju można przystąpić do klejenia paneli, nie wolno pozostawiać warstw kleju;
- minimalna temperatura podkładu mineralnego +15°C;

Pełne obciążenie przyklejonej posadzki po 72 godzinach, w międzyczasie podłogi nie myjemy na mokro oraz nie obciążamy - po 24 godzinach dopuszczalny ruch pieszych.

Klejenie do podkładu cementowego i anhydrytowego

- Podkład mineralny sprawdzić pod względem wytrzymałości (test twardości rysikiem stalowym), równości oraz określić jego temperaturę i wilgotność resztkową, np. przyrządem pomiarowym CM lub sondą elektryczną. Dopuszczalna wilgotność resztkowa do bezpośredniego klejenia paneli do podkładu cementowego wynosi 2,0% CM (z ogrzewaniem podłogowym 1,8%CM), do podkładu anhydrytowego wynosi 0,5% CM (z ogrzewaniem podłogowym 0,3%CM);
- Podkłady/ściany należy szlifować papierem/siatką P12/P16, odpowiednim segmentem szlifującym lub frezować w celu usunięcia warstwy o niskiej wytrzymałości, zanieczyszczeń budowlanych; dokładnie odkurzyć;
- nierówności powyżej 2 mm na 2 mb, 2 mm na 1 mb lub powyżej 0,2 mm na 20 cm, uskoki powyżej 0,2 mm wypełnić masą szybkowiążącą SERVOFINE F333 Kiesel Bauchemie;
- w celu związania pyłu i zwiększenia przyczepności masy samopoziomującej, podkład zagruntować gruntem TEC PRIMER D /OKATMOS EG20 /OKATMOS UG30 (1:1 z wodą) - czas schnięcia 60 minut dla p. cementowego, 24 godziny dla p. anhydrytowego (grunty: koncentrat) – **na grunty dyspersyjne stosujemy TYLKO klej TEC SPU**
- w przypadku podwyższonej wilgotności resztkowej jastrychu zastosować dwie warstwy „na krzyż” (druga warstwa po całkowitym wyschnięciu pierwszej) gruntu poliuretanowego jednoskładnikowego TEC PRIMER PU/PU FAST (do 4,0% CM), gruntu epoksydowego TEC PRIMER EPX/ OKAPOX GF (do 6,0% CM);
- na zagruntowany, wyrównany, czysty i suchy jastrych wykladać klej hybrydowy TEC SPU / TEC SPU 15 / TEC SPU 15 PLUS - paca TKB B15 – zużycie ok. 1,4 kg/m²;
- od razu po wyłożeniu kleju można przystąpić do klejenia paneli, nie wolno pozostawiać warstw kleju;
- minimalna temperatura podkładu mineralnego +15°C;

Pełne obciążenie przyklejonej posadzki po 72 godzinach, w międzyczasie podłogi nie myjemy na mokro oraz nie obciążamy - po 24 godzinach dopuszczalny ruch pieszych.

Klejenie do podkładów drewnopochodnych:

- płytę wiórową/OSB przeszlifować maszynowo papierem P40/P60, dokładnie odkurzyć ;
- szczeliny między płytami zalecamy wypełnić masą szybkowiążącą SERVOFINE F333 Kiesel Bauchemie;
- gruntować gruntami dyspersyjnymi – koncentrat – TEC PRIMER D, OKATMOS UG30, OKATMOSS EG20 : czas schnięcia 12h
- **na grunty dyspersyjne stosujemy TYLKO klej TEC SPU;**
- gruntować gruntami poliuretanowymi : TEC PRIMER PU, TEC PRIMER PU FAST
- na zagruntowany , wyrównany, czysty i suchy podkład drewnopochodny wykladać klej hybrydowy TEC SPU/TEC SPU 15/TEC SPU15 Plus - paca TKB B9 – zużycie ok. 1,1 kg/m²;
- od razu po wyłożeniu kleju można przystąpić do klejenia paneli, nie wolno pozostawiać warstw kleju;
- minimalna temperatura podkładu drewnopochodnego +15°C;

Pełne obciążenie przyklejonej podłogi po 72 godzinach, w międzyczasie podłogi nie myjemy na mokro oraz nie obciążamy - po 24 godzinach dopuszczalny ruch pieszych.

Klejenie kontaktowe i klejem PU 2K:

- Klejenie kontaktowe na schodach, ścianach, sufitach, w pomieszczeniach mokrych – TEC EXTRA paca TKB A1/A2 /A4 lub gładka/walek welurowy – zużycie ok. 0,3 kg/m².
- Klejenie klejem poliuretanowym dwuskładnikowym na schodach, ścianach, podkładach mineralnych i drewnopochodnych: TEC PU2K, TEC PU 2K PLUS, TEC P95NEW paca TKB B9/B15 – zużycie ok. 1,2 – 1,4 kg/m².

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać wymagań Producenta posadzki dotyczących klimatu wnętrza i metody układania.
Przedstawione zalecenie nie zastępuje Instrukcji Montażu Producenta posadzki.

Producent posadzki : WENINGER® ul. Rybnicka 81 44-350 Gorzyce

Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z powodu różnych niezależnych od nas czynników, np. nietypowe podkłady, warunki zewnętrzne i wewnętrzne, zmiany cech jakościowych i parametrów technicznych posadzki, umiejętności wykonawcy, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Bautec Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu oraz nie udziela rękojmi/gwarancji za wykonane prace.

Aktualizacja: 28.10.2024 r.